

闻泰科技股份有限公司 2022 年 3 月投资者关系活动记录表

编号：2022-03-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位及人员	<p>（排名不分先后）</p> <p>兴全基金：陈泓志、谢治宇、杨世进、邹欣等；景顺长城：杨锐文、詹成、程振宇等；申万菱信基金：付娟、梁国柱、周小波、廖明兵、诸天力、杨绍华、熊哲颖、卜忠林、许瀚天等；农银汇理：邢军亮、张燕等；中欧基金：尹苓、李波、李帅、刘金辉；东吴基金：丁戈、周健、欧阳力君、徐慢等；华安基金：谢磊；华富基金：朱程辉、姚姣姣、黄立冬、张惠、潘璐、沈成、范亮、戴弘毅、康诗韵；富国基金：王昭光等；信诚基金：王睿、吴昊、张弘、夏明月、孙浩中、郑弼禹、杨柳青等；泰康资产：邹志等；人保资产：孙秋波、汤祺等；贝莱德：唐华、邹江渝等；广发证券：栾玉民；兴业证券：谢恒；华创证券：耿琛、葛星甫、王帅等；国信证券：胡慧；方正证券：吴文吉；国元证券：张世杰；德邦证券：陈海进</p>
时间	2022 年 3 月 25 日-3 月 31 日
地点	电话会议
公司接待人员	董事会秘书高雨、战略部负责人吴友文、投关总监邓安明
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司近期经营情况介绍</p> <p>1.半导体业务。公司旗下安世半导体作为车规半导体龙头，2021 年前三季度保持快速增长态势，其盈利能力达到历史最高水平。四季度以来，安世进一步受益于汽车电动化、智能化对功率器件需求倍增的趋势，继续发挥车规半导体优势，不断提升盈利能力。</p> <p>2.产品集成业务。受益于 2020 年以来公司的战略布局与研发投入，公司产品集成业务现已发生了根本性改变，产品不断向多元化、高端化发展，实现从手机向笔电、IoT、服务器、汽车电子等非手机业务拓展，客户结构不断优化，从消费领域向工业、汽车等领域延伸。目前，手机 ODM 业务进展顺利，毛利率同比改善，非手</p>

机业务不断获取新客户、新订单，有序推进新项目。

3.光学业务。2021 年第四季度以来，光学业务完成了产品验证、量产并出货，进展良好。目前，公司光学业务处于常态化供货状态并加快推进新项目。

二、互动环节概要

1、公司半导体业务汽车需求方面的前景如何？

安世在汽车行业的出货占其收入的比重接近 50%，目前汽车需求是非常紧缺的，一方面是随着新能源汽车渗透率的加速提升，由于电动智能车单车功率半导体用量相对燃油车有数倍的增长，推动行业加速增长，而车规半导体供给端验证严格，总体来说供需很难在最近两三年缓解；另一方面，由于车规半导体大赛道的机会，全球其他主要的龙头模拟厂商在策略上有一定的调整，使得格局在向更有利于安世的方向发展，包括汽车和部分消费领域的更多功率和标准器件需求转向安世。

2、请问安世半导体新产品研发进展如何？

近期，公司自主设计研发的 IGBT 系列产品已流片成功，取得阶段性重大进展，各项参数均达到设计要求；专注于开发模拟信号转换和电源管理 IC 的研发中心在美国德州达拉斯正式启动，拟进入电源管理和信号转换等模拟市场。

同时，安世半导体也已研发出 100v 以上的中高压 MOSFET 新产品；化合物半导体（氮化镓、碳化硅）等进展顺利。安世半导体将通过更复杂和高功率的产品来强化和扩大其产品组合。

3、请问安世未来的扩产计划？

第一，2021 年公司收购的英国晶圆厂 Newport，进一步提升安世在 MOSFET、IGBT、模拟和化合物半导体等车规级产品的产能和工艺能力，2022 年将对安世产能扩张产生积极的贡献与影响；第二，对英国曼彻斯特和德国汉堡的晶圆厂的技术改造升级，生产效率得到进一步的提升；第三，公司正积极与外协合作伙伴沟通，适当增加外协产能；第四，由大股东先行建设的上海临港 12 吋车规级晶圆厂已经完成结构封顶，未来几年内将对安世产能形成数倍补充。此外，安世的封测工厂也在扩产。

4、公司产品集成业务在今年进展如何？

受益于 2020 年以来公司的战略布局与研发投入，公司产品集成业务现已发生了根本性改变，成功的在平板、笔电、IoT、服务器、汽车电子等更广阔的新领域获得更多优质国际客户的认证和导入，助力于产品集成业务发展成硬件流量平台。

	<p>手机业务也都进展顺利，毛利率同比改善；非手机业务也还在不断获取新客户、新订单，有序推进新项目。在过去两年加大开拓力度，去年以来在新客户新产品领域取得了良好的进展。近期，公司也公告了与境外特定客户在电脑、智能家居等方面的业务进展，公司针对新客户新产品相关项目的研发和规模量产准备也全方位展开，为未来的增长打好了坚实的基础。</p> <p>5、请问公司的研发投入是如何考虑的？</p> <p>公司的研发投入是为了支撑公司的战略与业务布局，实现公司快速增长目标。公司的战略是打造以半导体创新为龙头，硬件流量平台为基础的科技产品公司。其中，半导体业务，2021年以来安世不断研发拓展新产品，进入 IGBT、碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）以及模拟 IC 市场，以支持公司快速增长；产品集成业务，也从手机业务快速向非手机业务拓展，从而依托于半导体与部件的创新打造成多品类、多领域的流量平台，实现从服务型公司向产品型公司转型。</p> <p>从 2021 年一至三季度公司合并口径的研发费用来看，公司也是根据业务布局需要合理安排研发生产，并不存在研发无序扩张情况。目前，公司各个业务板块均处于快速成长期，也正按既定战略向前推进，从产品到订单都有新的突破，均是受益于前期的研发投入。公司相信，公司前期的研发投入定会带来公司经营发展与快速成长，公司一定会给股东们带来合理的投资回报。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022 年 4 月 2 日